

证券代码：300852

证券简称：四会富仕



四会富仕电子科技股份有限公司

Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd.

（四会市下茆镇龙湾村西鸦岗）

2026年度向特定对象发行A股股票 募集资金投资项目可行性分析报告

二〇二六年四月

四会富仕电子科技有限公司(以下简称“公司”或“四会富仕”)为满足公司主营业务发展的资金需求,增强公司资本实力,提升核心竞争力,公司拟向特定对象发行 A 股股票并募集资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规或规范性文件和《公司章程》的规定,公司编制了《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告》。

如无特别说明,相关用语具有与《四会富仕电子科技有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过 95,000.00 万元,扣除发行费用后,募集资金拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟以募集资金投入
1	年产 558 万平方米高可靠性电路板新建项目——年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目(一期)	四会富仕	109,236.13	95,000.00
合计			109,236.13	95,000.00

注:根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规的要求,本次发行董事会决议日前 6 个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 2,000.00 万元已从本次募集资金总额中扣减。

上述项目的实施主体为四会富仕。本次募集资金到位后,公司根据制定的募集资金投资计划具体实施。在募集资金到位前,公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目,待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,不足部分由公司自筹解决。

二、本次发行募集资金投资项目的基本情况

(一) 项目概况

类别	内容
项目名称	年产 558 万平方米高可靠性电路板新建项目——年产 60 万平方米高多层、HDI 电路板项目（一期）
实施主体	四会富仕电子科技股份有限公司
总投资	109,236.13 万元
主要建设内容	建设应用于服务器、光模块及工控、汽车电子等领域的高多层、HDI 电路板
建设地点	四会市龙甫镇惠源三路 1 号

（二）项目实施的必要性

1、顺应高端 PCB 市场结构性高速增长的核心趋势，抢占未来增长主赛道

当前全球 PCB 产业正经历深刻的结构性变革，传统低端产品增长趋缓，而高端产品，特别是高多层板和 HDI，正成为驱动行业增长的核心引擎。对于公司而言，持续拓展高多层板和 HDI 板等高端产品是对公司未来增长曲线的战略性重塑，是其在新一轮产业升级中立足的关键举措。

从市场规模与增速看，高端 PCB 市场发展迅速。根据 Prismark 的数据，2025 年，高多层板和 HDI 板的产值分别实现了 18.2% 和 25.6% 的同比增长，是所有 PCB 细分产品中增长最快的领域，预计 2024-2029 年高多层板和 HDI 板复合增长率分别为 9.0% 和 11.2%。

从下游应用驱动力分析，增长动能强劲。AI 算力基础设施、高速网络通信、智能电动汽车等新质生产力领域正成为高端 PCB 需求快速增长的关键。以 AI 服务器为例，其 GPU 板组扩容、架构升级对 PCB 的层数、材料及工艺提出了更高要求，推动 PCB 向高密度化、高集成化方向演进。

2、突破技术壁垒，构建面向未来的核心竞争力与护城河

高多层板和 HDI 板，尤其是应用于服务器、光模块等领域的高端产品，其制造工艺复杂，是涉及材料学、精密加工、信号完整性设计等多学科交叉的复杂系统工程。继续拓展高多层板和 HDI 板等高端产品，推动公司技术能力完成质的飞跃，从而构建起公司的核心竞争力和护城河。

高多层板的技术挑战核心在于“高密度”与“高性能”的协同实现。随着层

数向更高迈进，对 PCB 的层间对准度、阻抗一致性、散热性能及长期可靠性要求提高。HDI 板的技术壁垒则集中体现在“互连”和“高复杂度”上。HDI 通过使用微盲孔、埋孔来替代传统通孔，极大提升了单位面积的布线密度。高阶 HDI 的制造工艺需要循环重复“层压-激光钻孔-微孔电镀-线路”的工序，每增加一阶，良率控制的难度和成本都呈指数级上升，要持续开拓高端 HDI 市场，仍需在设备、工艺和人才上进行大规模、持续性的投入。本次募集资金是跨越这些关键的技术的资金保障，使公司从“具备能力”升级为“具备稳定、批量生产高端产品的能力”，从而在价值链上占据更有利的位置。

3、把握 AI 算力爆发与硬件迭代的历史性机遇，切入高附加值客户供应链

当前，以生成式人工智能为代表的科技革命正驱动全球算力基础设施快速扩张，不仅带来了量的增长，更引发了硬件架构的快速迭代，从而为上游 PCB 供应商创造了结构性的、高附加值的增量市场。公司持续拓展高多层板和 HDI 板业务，是为了完成从当前以工控、汽车电子为主的客户结构，向代表科技前沿的 AI 算力客户群延伸。

AI 服务器是高端 PCB 需求爆发的核心载体。一台 AI 服务器中，其 PCB 需求主要来自三个部分：（1）用于高密度互连的小型 AI 加速器模块（如 OAM），通常使用 4-5 阶 HDI；（2）通用基板（UBB），通常使用高多层板或 HDI；（3）传统的 CPU 主板，通常使用 4-6 层 PCB 板。根据 Prismark 数据，2023 年 AI/HPC 服务器的全球 PCB 市场规模接近 8 亿美元，预计到 2028 年将增长至 31.7 亿美元，2023-2028 年复合年增长率高达 32.5%，为 PCB 厂商提供了持续的订单和溢价空间。

公司要成为 AI 领域的核心供应商，需拥有规模化的高端产能和经过认证的稳定制程能力。公司当前的产能以满足样品和小批量需求为主，募投项目提升了公司生产大批量高多层板和 HDI 板的能力，是公司成为 AI 领域核心供应商的关键。

4、响应国家战略与产业政策导向，服务制造业高端化与自主可控大局

公司募投项目高度契合国家推动制造业高端化、智能化、绿色化发展的战略

方向，符合增强产业链、供应链自主可控能力的政策诉求。

高多层板和 HDI 板是电子信息产业的基础核心部件，其技术水平直接关系到下游 5G 通信、人工智能、数据中心、新能源汽车、网络通信等战略性新兴产业的发展质量和安全。当前，全球高端 PCB 产能主要集中在台湾、日本、韩国等地区的少数厂商手中。中国大陆 PCB 产业虽规模全球第一，但在产品结构上仍以中低端为主，推动本土 PCB 企业向高多层、高阶 HDI 等高端领域突破，是中国实现电子信息产业自立自强的重要一环。

公司募投项目所生产的高多层板及 HDI 板产能，巩固现有优势产品的同时，将直接应用于服务器、智能终端、光模块等国家明确鼓励发展的重点领域，通过本土化供应，降低下游重点产业对海外供应链的依赖，有利于提升整个产业链的韧性和安全水平。从资本市场和长期发展的角度看，符合国家战略导向的产业投资，更容易获得包括政策支持、银行信贷、市场认可在内的多方面资源倾斜，为公司穿越周期、持续成长营造更有利的外部环境。

5、应对高昂的资本开支需求，为先进产能建设与设备升级提供资金保障

高端 PCB 制造属于典型的技术密集型和资本密集型行业。从普通多层板向高多层、高阶 HDI 升级，需要新建或大规模改造厂房，并投入大量资金购置一系列专用生产设备，本次募集资金是应对这一资本开支的重要保障。

设备投资是高端 PCB 产能建设的最大支出项。以高多层板和 HDI 板为例，层数的增加、阶数的提升和材料的变化导致钻孔效率大幅降低，加工同样面积产品所需设备数量增加，且对高精度钻孔机需求提升。若仅依靠自身经营积累进行如此大规模的投资，将拖累公司现金流，错失市场快速发展的时间窗口。因此，通过资本市场进行股权融资，是平衡公司短期财务压力与长期战略投入、以最快速度搭建先进产能平台的最优选择。

（三）项目实施的可行性

1、深厚技术积累，为高端产能提供工艺支撑

自成立以来，公司始终专注于高品质 PCB 的研发与生产，在技术领域形成

了深厚的积累，这为其向更高层次的高多层板和 HDI 板业务拓展提供了坚实的技术支撑。

从研发体系与成果来看，公司已建立起成熟的创新机制，并获得了权威认可。公司是国家高新技术企业，获得了肇庆市企业技术中心、肇庆市工程技术研究中心、广东省高可靠性电路板设计与制造工程技术研究中心、广东省企业技术中心等认定，在高可靠性印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验。同时，公司形成了高多层高密度 HDI 互联技术、高多层背钻工艺技术、24~80 层 ATE 测试板技术、高频材料+FR4 混压技术、高频 77G 雷达 PCB 技术、HDI 铝基板的制作工艺研究与开发、厚铜（铜厚 4oz~15oz）PCB 技术、陶瓷 PCB 技术、50 层以上基板的制作工艺研究与开发、高多层刚挠结合板技术、Anylayer HDI 基板的制作工艺研究与开发、载板极薄铜箔的压合与加工、Mini LED 基板的制作工艺研究与开发、埋铜控深 PTH 基板的制作工艺研究与开发、嵌埋陶瓷复合基板的制作工艺研究与开发、Tenting 工艺 1.6T 光模块板制造技术、RCC 工艺 800G 光模块板制造技术、AI 加速卡高频混压 PCB 制造技术、高多层不对称结构背钻服务器基板制造技术等多项行业核心技术。截至本预案公告日，公司已经取得授权专利 35 项，其中发明专利 19 项，能够为高端产品的持续开发提供体系化的技术保障。

公司在泰国设立的生产基地已于 2024 年下半年开始逐渐投产，在技术上，公司攻克了高多层板和 HDI 板的核心制造工艺，掌握了从材料选型、图形转换、精密激光钻孔、层压对位、电镀填孔等一系列关键技术环节，能够满足光模块、服务器等对高可靠性、低阻抗的品质要求，已实现了高多层板与 HDI 板等产品的量产，为公司在国内建设更先进、更大规模的高端产能提供了宝贵的工艺参数、生产管理经验和人才储备和量产经验。

2、头部客户资源构成强大市场准入壁垒与客户转化基础

公司长期专注于工业控制、汽车电子等高可靠性 PCB 市场，与全球顶级客户建立的长期信任关系，构成了公司进军高多层板和 HDI 板市场坚实的护城河和可行性保障。

首先，工业控制和汽车电子对 PCB 的长期可靠性、耐高温、耐振动、耐腐

蚀以及低缺陷率要求严苛，公司在工控领域与头部企业松下、欧姆龙、安川电机、横河电机等知名客户建立了长期稳定的合作关系，在汽车电子领域从车钥匙、车灯、天线与车载娱乐系统等简单部件向 ECU、T-BOX、P-Box、转向马达、激光雷达、发动机控制板等核心安全部件渗透，公司的质量管理体系、生产过程控制能力、品控能力已达到国际一流水平。服务器、光模块领域对 PCB 的可靠性和信号完整性要求极高，公司具备深厚高可靠性制造背景，产品品质更容易获得新开发领域客户的认可，客户信任建立更快。

其次，现有头部客户资源存在巨大纵向挖掘与横向拓展潜力。公司的客户结构优质，且正在持续多元化。一方面，其传统的日系头部客户本身也在进行产业升级，其高端工控设备、机器人等产品对高多层板和 HDI 板的需求增长，公司可凭借长期合作建立的信任，优先获得老客户升级产品的订单，实现业务的自然延伸；另一方面，公司已成功开拓了服务器、光模块等领域的客户群，并获得了订单的高速增长。从工控、汽车电子的全球巨头，到服务器、光模块等领域的拓展，公司已构建了一个层次丰富、需求多元的优质客户池，这为新产能的消化提供了多层次的保障。

3、强大的人才队伍为项目实施提供保障

公司在多年的经营发展中，形成了较稳定、专业且具有丰富行业经验的管理团队。公司董事长刘天明先生毕业于日本东京大学，有着十多年的日资 PCB 企业工作和管理经验，公司核心员工多年在 PCB 企业从事生产、技术、销售、管理，对电路板生产制造及品质管理理念有着深刻理解，熟悉客户的工作流程和管理风格，能够与客户进行积极有效沟通。公司人员结构稳定，本地员工占 70% 以上，为本地员工提供有竞争力的薪酬；公司还通过股权激励机制吸引人才，增加员工对公司的归属感，为持续稳定生产高品质的 PCB 提供保证。

4、下游 AI 算力与汽车电子需求爆发，为新增产能提供了订单空间

高多层板和 HDI 板的下游需求正经历由 AI 算力和汽车智能化驱动的结构爆发，为公司的新增产能提供了订单保障。

首先，AI 服务器对高端 PCB 的需求呈指数级增长，且其技术迭代快、产品

附加值高，生成式 AI 的浪潮推动全球算力基础设施疯狂扩张。AI 服务器刺激 PCB 的需求爆发式增长，据广东省电路板行业协会数据，每一台 AI 服务器的 PCB 产值较传统服务器提升 5~7 倍，根据 PrismaMark 预测，2023-2028 年 AI 服务器相关 HDI 板的年均复合增速为 16.3%。公司光模块板产品技术能力得到市场前沿客户的认可，已获得客户批量订单，AI 服务器领域订单增长迅速，为新增产能消化提供保障。

其次，汽车智能化与电动化推动车用 PCB 市场量价齐升，高阶 HDI 渗透率快速提高。汽车电子领域是公司传统优势领域，这一领域正在发生深刻变革，新能源汽车的电子元件是传统燃油车的 3-4 倍，三电系统（电池、电机、电控）需要大量高可靠性 PCB，智能驾驶和智能座舱对数据处理能力要求飙升，推动车用 PCB 向高层数、高密度发展。公司已从车钥匙、车灯、天线与车载娱乐系统等简单部件向 ECU、T-BOX、P-Box、转向马达、激光雷达、发动机控制板等核心安全部件，具备了供应车规级高阶产品的基础。随着客户车型的迭代升级，对高阶 HDI 和高多层板的需求将会向公司释放，保障新增产能相当一部分可以被汽车电子业务消化。

（四）项目投资估算

本项目总投资金额为 109,236.13 万元，本次拟使用募集资金投入 95,000.00 万元，项目投资结构如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	建筑及安装工程费用	8,462.34	7.75%
2	设备购置及安装费用	76,067.35	69.64%
3	环保设备设施	3,369.46	3.08%
4	工程建设其它费用	10,455.26	9.57%
5	铺底流动资金	10,881.72	9.96%
合计		109,236.13	100.00%

（五）项目实施主体

本次项目实施主体为四会富仕电子科技股份有限公司。

（六）项目经济效益分析

经测算，本项目税后静态投资回收期为 7.49 年（含建设期），税后内部收益率为 13.65%。

（七）项目用地、项目备案、环评等报批事项

本项目建设地点位于四会市龙甫镇惠源三路 1 号，项目用地已由四会富仕以出让方式取得。公司已取得项目实施地编号为粤（2026）四会市不动产权第 0008304 号、粤（2026）四会市不动产权第 0008316 号、粤（2026）四会市不动产权第 0008321 号和粤（2026）四会市不动产权第 0008336 号的不动产权证书。

截至本报告公告日，公司取得了肇庆市生态环境局关于项目环境影响报告表的批复，项目备案相关手续尚在办理中，相关程序的办理预计不存在实质性障碍。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目投产后将扩大公司的经营规模，增强公司持续盈利的能力，促进经营业绩的提升。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，一方面，公司的总资产规模将相应提高，资金实力得到提升，公司整体财务状况将得到改善，另一方面募集资金所投资项目的经营效益需要一定时间才能体现，本次发行短期内会使公司每股收益被摊薄。

本次募集资金到账后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加，随着募集资金投资项目的实施及效益的产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加，公司整体现金流状况将得到进一步优化，公司的盈利能力和经营业绩将显著提升。

四、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，公司本次向特定对象发行 A 股股票具备必要性与可行性，发行

方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，本次发行将有利于进一步完善公司产业布局，提高公司经营业绩，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。

四会富仕电子科技股份有限公司董事会

2026年4月9日